

股票简称:气派科技 股票代码:688216

气派科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书

CHINA CHIPPACKING TECHNOLOGY CO.,LTD.
(深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区平龙西路250号1#厂房301-2)

保荐机构(主承销商) 华创证券有限责任公司

(贵州省贵阳市云岩区中华北路216号)
二〇二一年六月二十二日

(五)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股票情况

截至本上市公告书签署日,公司现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员及其近亲属持有本公司股份的情况如下(不含公司高级管理人员及核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售获配的情况)如下:

姓名	姓名	直接持股数(股)	间接持股数(股)	合计持股数(股)	限售期限	
梁大钟	董事长、总经理	51,150,000	气派致远 5,000	51,155,000	48.14%	36个月
白璞	董事	10,800,000	-	10,800,000	10.16%	36个月
施保球	董事、副总经理、总工程师	2,000,000	-	2,000,000	1.88%	12个月
邓大红	监事会主席	-	昆石天利 27,785.75 昆石创富 142.86	27,785.75 142.86	0.03% 0.0001%	12个月
赵宏伟	监事	90,000	-	90,000	0.08%	12个月
饶伟林	副总经理	280,000	-	280,000	0.26%	12个月
陈勇	副总经理	250,000	-	250,000	0.24%	12个月
胡明强	副总经理	300,000	-	300,000	0.28%	12个月
文正国	副总经理、董事会秘书	310,000	-	310,000	0.29%	12个月
李泽伟	财务总监	295,000	-	295,000	0.28%	36个月
梁宇飞	财务总监	50,000	-	50,000	0.05%	36个月

本公司高级管理人员及核心员工通过资产管理计划参与本次发行战略配售持有公司股票的情况,详见本节“七、战略配售”。

上述公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有公司股份的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”的相关内容。

(六)董事、监事、高级管理人员、核心技术人员持有公司债券情况

截至本上市公告书签署之日,公司向尚未发行过债券,公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有本公司债券的情况。

四、本次发行前公司的股本结构变动情况

本次发行前,公司总股本为7,970.00万股,本次公开发行新股2,657.00万股,发行后公司总股本为10,627.00万股。本次发行前公司的股本结构变动情况如下表所示:

股东名称	本次发行前		本次发行后		限售期限
	股份数量(股)	持股比例	股份数量(股)	持股比例	
一、有限售条件流通股					
梁大钟	51,150,000	64.18%	51,150,000	48.13%	自上市之日起锁定36个月
白璞	10,800,000	13.55%	10,800,000	10.16%	自上市之日起锁定36个月
邓大红	2,650,000	3.32%	2,650,000	2.49%	自上市之日起锁定12个月
梁大钟	2,300,000	2.89%	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定12个月
昆石天利	2,300,000	2.89%	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定12个月
施保球	2,000,000	2.51%	2,000,000	1.88%	自上市之日起锁定12个月
杨国忠	1,500,000	1.88%	1,500,000	1.41%	自上市之日起锁定12个月
昆石创富	1,500,000	1.88%	1,500,000	1.41%	自上市之日起锁定12个月
东莞红土	1,300,000	1.63%	1,300,000	1.22%	自上市之日起锁定12个月
深圳红土	1,000,000	1.25%	1,000,000	0.94%	自上市之日起锁定12个月
文正国	310,000	0.39%	310,000	0.29%	自上市之日起锁定12个月
胡明强	300,000	0.38%	300,000	0.28%	自上市之日起锁定12个月
李泽伟	295,000	0.37%	295,000	0.28%	自上市之日起锁定36个月
饶伟林	280,000	0.35%	280,000	0.26%	自上市之日起锁定12个月
陈勇	250,000	0.31%	250,000	0.24%	自上市之日起锁定12个月
林庆广	240,000	0.30%	240,000	0.23%	自上市之日起锁定12个月
刘明才	200,000	0.25%	200,000	0.19%	自上市之日起锁定12个月
梁晓英	160,000	0.20%	160,000	0.15%	自上市之日起锁定12个月
高安德	120,000	0.15%	120,000	0.11%	自上市之日起锁定12个月
李庆丹	100,000	0.13%	100,000	0.09%	自上市之日起锁定12个月
黄学贵	100,000	0.13%	100,000	0.09%	自上市之日起锁定12个月
李奎	100,000	0.13%	100,000	0.09%	自上市之日起锁定12个月
赵红	90,000	0.11%	90,000	0.08%	自上市之日起锁定12个月
雷刚	80,000	0.10%	80,000	0.08%	自上市之日起锁定12个月
刘方标	80,000	0.10%	80,000	0.08%	自上市之日起锁定12个月
徐锋	60,000	0.08%	60,000	0.06%	自上市之日起锁定12个月
梁瑞飞	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定36个月
靳毅平	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定12个月
陈国豪	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定12个月
祝小健	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定12个月
靳东海	50,000	0.06%	50,000	0.05%	自上市之日起锁定12个月
蔡佳俊	40,000	0.05%	40,000	0.04%	自上市之日起锁定12个月
刘涛	40,000	0.05%	40,000	0.04%	自上市之日起锁定12个月
郑尧	30,000	0.04%	30,000	0.03%	自上市之日起锁定12个月
陈亮	30,000	0.04%	30,000	0.03%	自上市之日起锁定12个月
气派致远	15,000	0.02%	15,000	0.01%	自上市之日起锁定36个月
兴贵投资有限公司	-	-	1,328,500	1.25%	自上市之日起锁定24个月
网下限售股份	-	-	952,972	0.90%	自上市之日起锁定6个月
小计	79,700,000	100.00%	84,638,472	79.64%	-
二、无限售条件流通股					
无限售条件流通股	-	-	21,631,528	20.36%	-
合计	79,700,000	100.00%	106,270,000	100.00%	-

发行人本次公开发行前的股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

六、本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行后,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	限售期限
1	梁大钟	51,150,000	48.13%	自上市之日起锁定36个月
2	白璞	10,800,000	10.16%	自上市之日起锁定36个月
3	华创证券-兴业银行-华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	2,657,000	2.50%	自上市之日起锁定12个月
4	深圳市新投资集团有限公司	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定12个月
5	北京昆石天利投资有限公司-北京昆石天利股权投资合伙企业(有限合伙)	2,300,000	2.16%	自上市之日起锁定12个月
6	施保球	2,000,000	1.88%	自上市之日起锁定12个月
7	深圳市新投资集团有限公司	2,000,000	1.88%	自上市之日起锁定12个月
8	董晓红	2,650,000	2.49%	自上市之日起锁定12个月
9	深圳市昆石投资有限公司-深圳市昆石股权投资企业(有限合伙)	1,500,000	1.41%	自上市之日起锁定12个月
10	兴贵投资有限公司	1,328,500	1.25%	自上市之日起锁定24个月
合计		78,185,500	73.57%	-

七、战略配售

本次发行涉及的战略配售包括保荐机构相关子公司兴贵投资有限公司和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的气派员工资管计划:

(一)保荐机构相关子公司参与战略配售情况
保荐机构安排保荐机构依法设立的投资子公司兴贵投资有限公司参与本次发行的战略配售,兴贵投资有限公司本次拟获配股票数量为132.85万股,占本次发行数量的5%,获配金额为19,688,370.00元,获配股票的限售期为24个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

(二)发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况
发行高级管理人员、核心员工通过气派员工资管计划参与本次发行的战略配售,获配股票数量为265.70万股,占本次发行数量的10%,相应的战略配售资金及相应新股配售经纪佣金合计为39,573,623.70元(其中获配股款对应的金额39,376,740.00元,相应的新股配售经纪佣金196,883.70元),获配股票的限售期为12个月,限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

具体名称:华创证券气派科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划
设立时间:2021年3月12日
募集资金规模:7,173.90万元

特别提示

气派科技股份有限公司(以下简称“气派科技”、“公司”或“发行人”)股票将于2021年6月23日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素,在新股上市初期切忌盲目跟从“炒新”,应当审慎决策、理性投资。

第一节 重要声明与提示

一、重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书披露信息的真实、准确、完整,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并依法承担法律责任。

上海证券交易所有关机构对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容,注意风险,审慎决策、理性投资。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书中简称或名称释义与本公司首次公开发行股票招股说明书释义相同。

本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入所致。

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,首日跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后的前5个交易日,公司股票价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
上市初期,原控股股东股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构根据锁定期为24个月,高管及核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售流通股为21,631,528股,占发行后总股本的20.36%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平
本次发行价格为14.82元/股,此价格对应的市盈率为:

1、15.84倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、14.70倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3、21.11倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

4、19.60倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”,截至2021年6月7日(T-3日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均动态市盈率为41.59倍,本次发行价格对应的公司2020年扣除非经常性损益后孰低的净利润摊薄后市盈率为21.11倍,低于行业最近一个月平均动态市盈率,但仍存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

(四)股票上市首日即可作为融资融券标的

科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,有可能产生一定的价格波动风险,市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指融资融券加标的股票的价格波动,市场风险是指投资者在将股票作为担保品进行融资时,不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险,还得承担担保股票价格变化带来的风险,并支付相应的利息;保证金追加风险是指投资者在交易过程中需要全程监控担保率水平,以保证其不低于融资融券业务维持的担保比例;流动性风险是指的股票发生剧烈价格波动时,融资融券或卖空还款、融券卖出或买空还款可能会受阻,产生较大的流动性风险。

三、特别风险提示

公司特别提醒投资者注意,在作出投资决策之前,特别关注以下重大风险提示,并认真阅读招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容。

(一)以传统封装产品为主,先进封装市场竞争日趋激烈

根据Yole相关预测,从2019年至2025年,全球半导体封装市场的营收将以1%的年复合增长率增长,其中先进封装市场将以6.6%的年复合增长率增长,传统封装市场将以1.9%的年复合增长率增长。根据中国半导体行业协会发布的《中国半导体产业未来发展状况报告(2020年版)》,到2019年底,国内封装企业仍以传统封装为主,先进封装的销售占比仅为35%。

报告期内,公司主要封装产品仍以传统封装为主,先进封装的销售占比为47.9%。报告期内,国内封装企业来源于SOP、SOT等传统封装形式产品,公司SOP、SOT等传统封装形式产品实现的主营业务收入分别为33,169.46万元、35,991.83万元、42,739.27万元,占当期主营业务收入的比例分别为93.11%、91.42%、80.74%。

相较于行业内领先企业,公司在先进封装技术方面的研发投入及储备投入不足,因而公司在FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SP、TSV等先进封装领域的产品设计、工艺投入、研发投入等与日月光、安集、长电科技、华天科技、通富微电等国内领先企业存在较大的技术差距。该等技术差距导致公司产品在先进封装产品应用领域、市场占有率、高端封装产品等方面处于追赶地位,公司在先进封装产品市场的竞争力相对较弱。如果未来公司不能通过持续培养和引进外部高素质研发技术人员,加大对先进封装技术的研发投入缩小与国内外领先企业的技术差距,将无法开发出满足市场需求的3D、CSP、WLCSP、MCM、SP、TSV等先进封装形式产品,将导致公司核心竞争力下降,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(二)集成电路封装测试领域技术及产品升级迭代风险

近年来,集成电路封装测试产品的多任务、小体积的发展趋势带动了集成电路封装技术朝着高性能、高密度、高热流、晶圆级、薄型化、小型化方向快速发展,相应的FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SP、TSV等先进封装技术应用领域越来越广泛。日月光、安集、长电科技、华天科技、通富微电等国内外领先企业均已掌握FC、3D、CSP、WLCSP、MCM、SP、TSV等先进封装技术,而公司产品目前仍以SOP、SOT等传统封装形式为主,相应的公司产品面临技术升级迭代风险。如果未来公司的封装技术与工艺不能跟上竞争对手新技术、新工艺的持续升级换代,将可能使得公司产品市场空间变小,或者公司不能对封装测试产品的应用领域和终端市场进行精准判断,快速识别并响应客户需求的变化,在新产品、新技术研发方面无法保持持续投入,或者正在研发的新产品不能满足客户需求,将难以开拓新的业务市场;进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(三)市场竞争加剧风险

一方面,长电科技、通富微电、华天科技等国内领先企业不仅通过资本市场募集资金增加生产线,进行技术和产品的升级改造提升产品品质、质量和技术水平,还通过收购兼并进一步实现了产能的大幅提升和技术的升级换代。另一方面,外资和合资封装测试企业进一步布局中国大陆,加大了资金和研发投入。因此,公司作为国内集成电路封装测试第二梯队企业,相关产品不仅面临国内、国际同行业企业的激烈竞争,还面临行业潜在或新进企业的竞争威胁。如未来集成电路封装测试行业市场竞争进一步加剧,将可能导致公司产品市场竞争力下降,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

此外,公司目前产品结构仍以传统封装为主。传统封装虽然市场规模大且保持持续增长,但相比先进封装,传统封装增速趋缓,同时,主流传统封装技术成熟,传统封装产品以标准化产品为主,存在同质化竞争的情形,因而传统封装市场竞争更为激烈。若公司不能持续保持传统封装产品的市场竞争力,将导致公司的经营业绩造成不利影响。

(四)公司自主定义的Qpqi、CPCQ、CFDN系列产品市场空间受限的风险

报告期内,公司自主定义的Qpqi、CPCQ系列产品实现的营业收入分别为2,511.20万元、2,353.17万元、1,903.39万元,占当期主营业务收入的比例分别为7.05%、5.98%、3.60%;公司自主定义的CQFN/CFDN产品已进入小批量生产阶段。

公司自主定义的Qpqi、CPCQ、CQFN/CFDN封装形式产品为非标产品,存在与其它封装形式的兼容性问题,客户终端用户会对供货能力和供应的可靠性进行选择;此外,使用新型封装形式需要重新设计、认证流程长,对性能复杂的终端产品需要进行各种性能、安全、可靠性等认证并得到用户的认可,相应的Qpqi、CPCQ、CQFN/CFDN封装形式产品已有产品的替代程序较多、周期较长。受前述原因影响,公司自主定义的Qpqi、CPCQ、CQFN/CFDN封装形式产品存在不能得到市场广泛认可而导致市场增长或空间受限的风险。

(五)先进制程芯片封装能力较弱及12吋晶圆尺寸封装产品很少的风险

公司报告期内封装测试产品芯片制程仅90纳米以上为主,占比超过95%,90纳米以下制程占比很低。随着芯片制程技术的快速发展,先进节点已走向10微米、7微米、5微米、3微米制程,先进制程的芯片集成度越高,芯片输出端口越多,封装脚位越多,相应的封装可靠性越高,对封装技术水平要求相应提高。目前公司封装产品制程以90纳米以上为主,先进制程芯片封装能力较弱,与日月光、安集、长电科技、华天科技、通富微电等国内领先企业存在较大的技术差距。

报告期内,公司封装测试产品所用晶圆以6吋、8吋为主,占比超过90%,12吋占比很低。单片12吋晶圆能生产更多芯片,已经成为全球先进制程工艺的主流,但由于尺寸更大,使得其设备投入更高,加工工艺及品质管控更具挑战性。公司目前封装形式产品所用晶圆主要为8吋以下,12吋晶圆占比与国内外领先企业存在一定的差距。

若未来公司不能通过持续的研发投入及技术升级缩小与国内外领先企业在先进制程芯片封装技术、12吋晶圆尺寸产品上的差距,将导致公司核心竞争力下降,进而对公司的经营业绩造成不利影响。

(六)销售区域集中风险

报告期内,公司业务主要集中在华南地区,2018年至2020年,公司来自于华南地区的主营业务收入占比分别为62.59%、59.51%和54.53%。如果华南地区的销售情况出现重大不利变化,将对公司业务发展产生不利影响。

(七)业绩及毛利率波动风险

公司主要从事集成电路封装测试业务,经营业绩会随着终端产品市场的波动而变化;同时,集成电路封装测试行业竞争激烈,价格相对透明,相应的封装测试企业整体毛利率水平不高,2018年至2020年,公司主营业务毛利率分别为18.93%、20.75%和28.33%。

未来若终端产品市场出现较大波动,或者随着市场竞争的加剧,竞争者的数量增多及技术服务升级导致公司调整产品及服务的定价,降低产品毛利率,公司产品毛利率水平存在较大幅度波动的风险,从而对公司经营业绩和盈利能力产生不利影响。

(八)实际控制人不当控制

本次发行前,梁大钟、白璞夫妇合计直接持有公司77.73%的股份,梁大钟通过气派致远间接控制公司0.02%的股份,同时梁大钟担任公司董事长、总经理,白璞担任公司董事;梁大钟、白璞夫妇为公司的实际控制人。本次发行完成后,梁大钟、白璞仍将持有公司58.29%的股份,梁大钟通过气派致远间接控制公司0.01%的股份(假設公司公开发行新股2,657万股,且未发生老股转让),梁大钟、白璞仍将成为公司实际控制人。未来梁大钟、白璞若不能很好的约束自身行为,通过股东大会行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配、人事安排等重大事项予以不当控制,将可能对公司发展产生不利影响,损害公司及其他股东的利益。

(九)进口设备依赖的风险

截至2020年12月31日止,公司现有机器设备中无国产替代的进口设备原值为24,072.71万元,已有国产替代的进口设备原值为24,986.53万元,该等进口设备广泛应用于融合、封装、减薄切片、切磨成型、测试等生产工序,对公司生产经营十分重要。同时,公司本次募集资金投资项目将向日本东京精密株式会社、ASM、日本东邦株式会社等境外知名集成电路设备生产商采购设备31,564.18万元(含税),其中暂无国产替代的进口设备26,555.62万元(含税),已有国产替代的进口设备5,008.56万元(含税)。

截至目前,公司现有进口设备及募集资金投资项目所需进口设备未受到管制。若未来国际贸易摩擦持续中美贸易冲突加剧,美国进一步加大对半导体生产设备及其生产技术的出口管制力度和范围,如中国现有进口设备出现使用受限的情形,则本公司生产经营将受到较大不利影响;如募集资金投资项目所需进口设备被限制进口或受管制,则将对本公司募集资金投资项目的顺利实施带来不利影响,从而影响到公司发展战略及发展目标实现,将对公司未来发展和经营业绩造成较大不利影响。

第二节 股票上市情况

一、股票注册及上市审核情况

(一)中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1714号”文同意注册,具体内容如下:

“一、同意你公司首次公开发行股票注册申请。

二、你公司本次发行股票招股报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案

二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票(以下简称“新股”)上市初期的投资风险,广大投资者应充分了解风险,理性参与新股发行。

具体而言,上市初期的风险包括但不限于以下几种:

(一)涨跌幅限制放宽
上海证券交易主板、深圳证券交易所主板,在企业上市首日涨幅限制比例为44%,首日跌幅限制比例为36%,之后涨跌幅限制比例为10%。科创板企业上市后的前5个交易日,公司股票价格不设涨跌幅限制;上市5个交易日后,涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易主板、深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。

(二)流通股数量较少
上市初期,原控股股东股份锁定期为36个月或12个月,保荐机构根据锁定期为24个月,高管及核心员工专项资产管理计划锁定期为12个月,网下限售股锁定期为6个月。本次发行后本公司的无限售流通股为21,631,528股,占发行后总股本的20.36%,公司上市初期流通股数量较少,存在流动性不足的风险。

(三)市盈率低于同行业平均水平
本次发行价格为14.82元/股,此价格对应的市盈率为:

1、15.84倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算);

2、14.70倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);

3、21.11倍(每股收益按照2020年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算);